

平成 23 年 1 月 20 日

報道関係各位

社団法人 電子情報技術産業協会

— 設計維新！ —

『 Electronic Design and Solution Fair 2011 』

1 月 27 日(木)・28 日(金) パシフィコ横浜にて開催

社団法人 電子情報技術産業協会 (JEITA/会長: 下村節宏・三菱電機株式会社 取締役会長) は、来る 1 月 27 日 (木) 及び 28 日 (金) の 2 日間、横浜国際平和会議場 (パシフィコ横浜) にて、設計ソリューションの必須技術を網羅する展示会『Electronic Design and Solution Fair 2011』〔略称: EDSFair 2011 (イー・ディー・エス・フェア 2011)〕を開催します。

EDSFair は、国内随一の「設計ソリューション・設計技術・EDA 技術やそれらを活用した IP ソリューション・設計サービス」に特化した展示会です。

11 回目となる今回は、厳しい国際競争の中、日本の産業競争力を向上させ、世界をリードすべく「設計維新！」を開催テーマに、性能向上、リスクコスト削減、低消費電力化、地球環境保全などの課題を解決する新しい設計ソリューションや、世界最先端技術・サービスを披露します。

今回の開催規模は、出展者 118 社・団体が 199 小間を出展、会期 2 日間で 10,000 名の来場を見込んでいます。

■最先端の技術動向を習得できる場

開催初日の 1 月 27 日 (木) には、株式会社 NTT ドコモ 執行役員 研究開発推進部長・尾上誠蔵氏を迎え、キーノートスピーチ「いよいよ始まる次世代携帯電話 LTE」を実施するほか、開催 2 日間を通して特設ステージや出展者セミナーなど最新の技術動向が把握できるセミナー・講演が実施されます。

■新しい技術との出会いの場

EDSFair には、普段接する機会が少ない国内外の新興ベンダが毎回多数出展し、設計開発者に向けて世界の最新情報をいち早く紹介しています。期間中、「新興ベンダ・ガイド・ツアー」として、設計技術・EDA 技術の第一人者がツアー・ガイドとしてブースへ同行訪問し、各社の技術紹介・質疑応答をサポートします。また、大学研究室による設計技術に関する研究成果の発表も行われるなど、新しい技術に出会う機会を提供します。

■出展者と来場者の交流を深める場

今開催では、ビジネスタイムには外出しにくい多忙な設計者などが来場しやすい環境を作るために、1 月 27 日 (木) の開場時間を 20:00 まで延長し、18:00~20:00 を“プレミアムアワー”として、以下の特別企画を実施します。

また、1 月 28 日 (金) の開催時間終了後の 18:00~19:00 に“ワインの夕べ”を開催し、来場者と出展者の効率的かつ効果的なコミュニケーションとビジネス機会を創出します。

○1 月 27 日 (木) 18:00-20:00 “プレミアムアワー” 限定の特別企画

①「iPad」(10 名様) が当たる来場者プレゼント抽選会 (19:00 以降)

②会場内で「スニッカーズ」無料配布

③ASP-DAC コラボ企画セッション「LSI・パッケージ・ボード協調設計はどのように行われているか？」

④各出展ブースでもプレミアムアワー限定イベントを実施

○1 月 28 日 (金) 18:00-19:00 “ワインの夕べ” (参加無料)

報道関係各位におかれましては、是非ご来場くださいますようお願い申し上げます。

なお、ご来場の際には、展示会場内（会議室：No. DM5）に設置しますプレスルームにて、プレス証を発行いたしますので、お立ち寄りくださいますようお願い申し上げます。

以上

本件に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

運営事務局：一般社団法人 日本エレクトロニクスショー協会 担当：大西
TEL：(03) 6212-5231 FAX：(03) 6212-5225 E-mail：info2011@edsfair.com

EDSFair2011 公式 Website <http://www.edsfair.com>

開催概要

- 名称：Electronic Design and Solution Fair 2011 (EDSFair 2011)
- 会期：2011年1月27日(木) 10:00～20:00 [18:00～20:00 プレミアムアワー]
1月28日(金) 10:00～18:00 [18:00～19:00 ワインの夕べ]
- 会場：パシフィコ横浜(展示ホール/アネックスホール) 横浜市西区みなとみらい1-1-1
- 入場：無料(登録制)
- 主催：(社)電子情報技術産業協会(JEITA)
- 協力：Electronic Design Automation Consortium (EDAC)
- 後援：経済産業省、アメリカ合衆国大使館、外国系半導体商社協会(DAFS)、横浜市
- 協賛：(社)電子情報通信学会(IEICE)、(社)情報処理学会(IPSJ)、(社)日本電子回路工業会(JPCA)
- 同時開催：ASP-DAC (16th Asia and South Pacific Design Automation Conference)

《ご参考》 Electronic Design and Solution Fair 2010

出展者数：113社・団体
出展小間数：231小間
登録来場者数：9,300名

最先端の技術動向を習得できる場

■キーノートスピーチ(聴講無料/WEB事前申込制)

- ★日時：1月27日(木) 10:30～11:30
- ★場所：パシフィコ横浜 アネックスホール
- ★『いよいよ始まる次世代携帯電話LTE』 尾上 誠蔵 氏/(株)NTTドコモ 執行役員 研究開発推進部長

■特設ステージ(場所：展示フロア内/聴講無料)

【1月27日(木)】

- ★オープニング(13:00～13:15)
- ★セッション1(13:15～14:30) システムLSI設計の今後 ～22nm時代に向けて～
- ★セッション2(16:00～17:30) 設計維新：こうすればできる、LSI・パッケージ・ボードの協調設計
～協調設計が日本の製品を変える！～
- ★セッション3(18:00～18:45) ASP-DAC(第16回アジア南太平洋設計自動化会議) コラボ企画
LSI・パッケージ・ボード協調設計はどのように行われているか?
～協調設計の事例紹介と普及への課題～

【1月28日（金）】

★セッション4（10:30～12:00） 「設計者が語る成功へのヒント、失敗の教訓」

★セッション5（16:00～17:30） ユーザから見た携帯電話の省エネ技術

～スマートフォンへ向けた取り組み

新しい技術との出会いの場

■特別ゾーン

★新興ベンダエリア

普段接することが少ない国内外のベンチャー企業が集まり、設計開発者に向けて世界の最新情報をいち早く紹介するエリアです。

★新興ベンダ・ガイド・ツアー（参加無料）

日本の設計技術・EDA 技術の第一人者がツアー・ガイドとしてブースへ同行訪問し、各社の技術紹介・質疑応答をサポートします。

●集合場所：特設ステージ

1月27日（木）	①14:45～15:55
1月28日（金）	②13:00～14:10 ③14:45～15:55

★JEVeC ビレッジ

日本 EDA ベンチャー連絡会（JEVeC）との協力により、国内ベンチャー企業が一堂に集結し、日本企業ならではの「ものづくり力」をアピールします。

★ユニバーシティ・プラザ

8大学／研究室が、設計技術に関する研究成果を発表します。

- * 「非同期式回路の設計技術」（会津大学）
- * 「VLSI における新しい故障モデルに基づく故障検査法の開発」（愛媛大学）
- * 「生体情報センシングシステム」（大阪大学）
- * 「LSI の低消費電力テスト技術と劣化検知技術」（九州工業大学）
- * 「素子劣化を考慮した回路設計技術」（九州工業大学）
- * 「モデルベース LSI 設計」（東海大学）
- * 「システムレベルにおける高速性能見積りをういた MPSoC の設計空間探索と性能改善支援」（名古屋大学）
- * 「多層プリント配線基板設計支援システム MULTI-PRIDE」（広島大学）

出展者と来場者の交流を深める場

★来場者ブーススタンプラリー・プレゼント（参加無料）

展示会場内にて、来場者を対象にスタンプラリーを実施、開催期間中を通じてギフト券（1,000 円相当×700 名様）を抽選でプレゼントします。

また、1月27日（木）19:00～20:00 までの1時間限定で特賞：iPad（10 名様）を抽選でプレゼントします。

★プレミアムアワー（参加無料）

1月27日（木）の18:00～20:00 をプレミアムアワーとして、展示会場内や出展者ブースにおいて、より深いコミュニケーションの図れる特別企画を実施します。

★ワインのタベ（参加無料）

1月28日（金）の開催時間終了後の18:00～19:00 に、展示会場内・特設ステージにて、来場者と出展者の交流の場として、「ワインのタベ」を実施します。